

中信证券股份有限公司
关于宝鼎科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022年8月23日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862号），获准向招金有色金属矿业有限公司发行股份募集配套资金不超过3亿元。2022年9月23日，中信证券将扣除承销服务费后的认购款项的剩余款项划转至上市公司指定账户中。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月23日出具的《验资报告》（中天运[2022]验字第90052号），截至2022年9月23日止，本次募集资金总额人民币299,999,994.84元，扣除各项不含税发行费用13,911,972.06元，募集资金净额为286,088,022.78元。扣除承销费用（含增值税）14,000,000.00元后，公司实际收到募集资金为人民币285,999,994.84元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金累计投入296,931,256.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元；于2022年9月23日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币296,931,256.56元；本年度使用募集资金96,752,588.68元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币12,026,381.18元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，上市公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项账户3310010610120100216175，并于2022年10月19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子公司”）在中国工商银行股份有限公司招远支行（以下简称“工商银行招远支行”）开设募集资金专用账户1606021729200238706，并于2023年7月19日与公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，上市公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账号	余额
宝鼎科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州西湖支行	3310010610120100216175	75,930.12
山东金宝电子有限公司	中国工商银行股份有限公司招远支行	1606021729200238706	11,950,451.06
合计	--	--	12,026,381.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2025年度公司募集资金实际使用情况详见本核查意见“附表一：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，并于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过，将“7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔”募投项目投资规模进行调减，由年产7,000吨减少到2,000吨，项目总投资由66,567.99万元减少到25,700.00万元，其中募集资金投入由25,000.00万元减少到18,000.00万元，其余7,700.00万元为金宝电子自筹资金投入。公司将调减后结余募集资金7,000.00万元及利息永久补充流动资金。具体情况详见本核查意见“附表二：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及上市公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

公司年度审计会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宝鼎科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（大华核字【2026】0011002320号），认为“宝鼎科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了宝鼎科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。”

七、独立财务顾问核查意见

宝鼎科技2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的审批

程序，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况一致。

（以下无正文）

附表一：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		299,999,994.84			本年度投入募集资金总额		96,752,588.68			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		296,931,256.56			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.金宝电子“2,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目”	是	250,000,000.00	180,000,000.00	18,147,366.28	168,326,039.32	93.51		注		是
2.补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	是	49,999,994.84	119,999,994.84	78,605,222.40	128,605,217.24	107.17		不适用		否
承诺投资项目小计		299,999,994.84	299,999,994.84	96,752,588.68	296,931,256.56	98.98				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	2024年8月22日及9月12日，上市公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目投资规模及永久补充流动资金的议案》，将募投项目规模从年产7,000吨减少到2,000吨，总投资规模从6.65亿减少到2.57亿，其中配套募集资金从2.5亿减少到1.8亿；并将结余募集资金及利息永久补充流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	市场环境发生较大变化，2021至2023年，我国电子铜箔产能迅速增长超过下游电子行业需求增长。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2024年4月10日，上市公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意上市公司将募投项目由招远市金宝电子材料产业基地内（招远市国大路268号）变更至山东省烟台市招远市开发区金晖路229号，详见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-031）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	调减募投项目投资规模后，将结余募集资金7,000.00万元（不包含利息）									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：因金宝电子“2,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目”于2024年12月达到预定可使用状态，2025年度高速高频板5G用（HVLP）铜箔处

于试生产阶段，尚未产生效益。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
金宝电子“2,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目	金宝电子“7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目	180,000,000.00	18,147,366.28	168,326,039.32	93.51		注		否
补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	119,999,994.84	78,605,222.40	128,605,217.24	107.17		不适用		否
合计	-	299,999,994.84	96,752,588.68	296,931,256.56	98.98	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目投资规模及永久补充流动资金的议案》。公司拟将募投项目从年产7,000吨减少到2,000吨，总投资规模从6.65亿减少到2.57亿，其中配套募集资金从2.5亿减少到1.8亿						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：因金宝电子“2,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目”于2024年12月达到预定可使用状态，2025年度高速高频板5G用（HVLP）铜箔处于试生产阶段，尚未产生效益。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

张 昕

张子晖

中信证券股份有限公司

2026年3月19日